

| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>TIPO DE FILM</b>       | <b>ESPESOR (mils)</b>                  | <b>CARACTERÍSTICAS</b>   |
|---|---------------------------|--|--|
| Copper, Tin, Plating<br>Print / Tent & Etch                 | <b>Ordyl Alpha 300</b>    | 1.2 (Alpha 330)                        | Gran resistencia a soluciones alcalinas.   |
|   |                           | 1.6 (Alpha 340)                        | Gran Resistencia a deposiciones de Níquel/Oro.   |
|   |                           | 2.0 (Alpha 350)                        |  |
|   |                           | 3.0 (Alpha 375)                        |  |
|   | <b>Ordyl Alpha 800</b>    | 1.0 (Alpha 825)                        | Gran flexibilidad y alta conformabilidad.  |
|   |                           | 1.2 (Alpha 830)                        | Fácil de estripar, con tamaño pequeño de partícula.  |
|   |                           | 1.6 (Alpha 840)                        |  |
|   |                           | 2.0 (Alpha 850)                        |  |
|   | <b>Ordyl Alpha 900</b>    | 0.8 (Alpha 920)                        | Gran flexibilidad y alta conformabilidad.  |
|   |                           | 1.2 (Alpha 930)                        | Buena polimerización.  |
|   |                           | 1.6 (Alpha 940)                        | Fácil de estripar, con tamaño pequeño de partícula.  |
|   |                           | 2.0 (Alpha 950)                        |  |
|   |                           | 2.4 (Alpha 960)                        |  |
|   | <b>Ordyl AM 100</b>       | 1.2 (AM 130)                           | Excelentes propiedades de adherencia.  |
|   |                           | 1.6 (AM 140)                           | Alta velocidad de insolado.  |
|   |                           | 2.0 (AM 150)                           | Gran flexibilidad y conformabilidad.   |
|   |                           | 3.0 (AM 175)                           | Resistencia a soluciones alcalinas.  |
|   | <b>Ordyl AR 200S</b>      | 1.6 (AR 240S)                          | Gran flexibilidad y conformabilidad.   |
|   |                           | 2.0 (AR 250S)                          | Resistencia a soluciones alcalinas.  |
|   | <b>Ordyl FLR 4000</b>     | 1.2 (FLR 4030)                         | Excelentes propiedades de adherencia.  |
| 1.6 (FLR 4040)  |                           | Alta velocidad de insolado.            |  |
| 2.0 (FLR 4050)  |                           | Gran flexibilidad y conformabilidad.   |  |
|   |                           | Partícula muy pequeña en el estripado. |  |
| Copper, Tin, Plating<br>Print / Tent & Etch<br>LDI Exposure | <b>Ordyl Alpha 900NDI</b> | 0.8 (Alpha 920NDI)                     | No provoca residuos en el revelado.  |
|   |                           | 1.2 (Alpha 930NDI)                     | Muy buena polimerización, también con equipos LDI, y con espesores de film superiores a 50 micras. |
|   |                           | 1.6 (Alpha 940NDI)                     |  |
|   |                           | 2.0 (Alpha 950NDI)                     |  |
|   |                           | 2.4 (Alpha 960NDI)                     | Fácil de estripar, con tamaño pequeño de partícula.  |
|   | <b>Ordyl AM 100DI</b>     | 0.6 (AM 115DI)                         | Excelente polimerización, también con equipos LDI, y con espesores de film superiores a 50 micras. |
|   |                           | 0.8 (AM 120DI)                         |  |
|   |                           | 1.2 (AM 130DI)                         |  |
|   |                           | 1.6 (AM 140DI)                         | Excelentes propiedades de adherencia debidas a un promotor de adherencia especial.                 |
|   |                           | 2.0 (AM 150DI)                         | Velocidad muy alta de insolado.  |
|   |                           | 2.4 (AM 160DI)                         | Gran flexibilidad y conformabilidad.   |
|   |                           |  | Resistencia a soluciones alcalinas.  |
|   | <b>Ordyl FLR 1000</b>     | 1.2 (FLR 1030)                         | Excelente polimerización, también con equipos LDI con espesores de film superiores a 50 micras.    |
|   |                           | 1.6 (FLR 1040)                         |  |
|   |                           | 2.0 (FLR 1050)                         |  |
|   |                           |  |  |

|   |                        |                  |   |
|---|------------------------|------------------|---|
|   |                        |                  | Excelentes propiedades de adherencia debidas a un promotor de adherencia especial.<br>Alta velocidad de insolado.<br>Gran flexibilidad y conformabilidad.<br>Partícula muy pequeña en el estripado. |
| Copper, Tin, Plating<br><br>Print / Tent & Etch<br>405 nm LDI<br>exposure | <b>Ordyl AM 400</b>    | 1.2 (AM 430)     | Tiempos de insolado muy cortos trabajando a una longitud de onda de 405 nm.<br><br>Resistencia a soluciones alcalinas.  |
|   |                        | 1.6 (AM 440)     |   |
|   |                        | 2.0 (AM 450)     |   |
|   | <b>Ordyl AM 900</b>    | 1.2 (AM 930)     | Tiempos de insolado muy cortos.<br>Adecuado para trabajar con longitudes de onda UV estándar y de 405 nm.   |
|   |                        | 1.6 (AM 940)     |   |
|   |                        | 2.0 (AM 950)     |   |
|   | <b>Ordyl FLR 9000</b>  | 1.2 (FLR 1030)   | Tiempos de insolado muy cortos.<br>Adecuado para trabajar con longitudes de onda UV estándar y de 405 nm.<br><br>Partícula muy pequeña en el estripado.   |
|   |                        | 1.6 (FLR 1040)   |   |
|   |                        | 2.0 (FLR 1050)   |   |
| Chemical Milling  | <b>Ordyl AF 200E</b>   | 1.2 (AF 230E)    | Excelente adherencia sobre acero inoxidable.  |
|   |                        | 1.6 (AF 240E)    | Adecuado para equipos LDI.  |
|   |                        | 2.0 (AF 250E)    |   |
|   | <b>Ordyl AF 200LDI</b> | 2.0 (AF 200 LDI) | Excelente adherencia sobre acero inoxidable.<br>Adecuado para equipos LDI.  |
|   |                        |                  |   |
| Chemical Milling<br><br>Electroforming<br>ENIG process                    | <b>Ordyl NE 500</b>    | 0.6 (NE 515)     | Excelente adherencia sobre acero inoxidable.  |
|   |                        | 1.0 (NE 525)     | Muy buena resistencia en proceso ENIG.  |
|   |                        | 1.6 (NE 540)     | <i>Ultra Fine Line</i>  |
|   |                        | 2.0 (NE 550)     |   |
| Ultra Fine Line   | <b>Ordyl FP 400</b>    | 0.6 (FP 415)     | Excelente resolución hasta 1:2 (por ejemplo, se puede conseguir una resolución de 20 micras con espesores de film de 40 micras).  |
|   |                        | 1.0 (FP 425)     |   |
|   |                        | 1.6 (FP 440)     |   |
|   |                        | 2.0 (FP 450)     |   |
|   | <b>Ordyl FP 700</b>    | 0.8 (FP 720)     | Excelente resolución hasta 1:2 (por ejemplo, se puede conseguir una resolución de 20 micras con espesores de film de 40 micras).  |
|   |                        | 1.6 (FP 740)     |   |
| Packaging   | <b>Ordyl P-50000</b>   | 4.0 (P50100)     | Excelente polimerización incluso con espesores superiores a 100 micras.   |
|   |                        | 5.0 (P50125)     |   |
| Permanent resist for MEMS and Biochips Packaging                          | <b>Ordyl SY 300</b>    | 0.8 (SY 320)     | Excelente resistencia química.  |
|   |                        | 1.6 (SY 330)     | Biocompatible.  |
|   |                        | 2.2 (SY 355)     | Resistente al calor.  |
|   |                        |                  | Buena resolución.   |